

## 先進リワークステーションSUMMIT-II ダイナミックハイトセンシング- 非接触はんだ除去機能

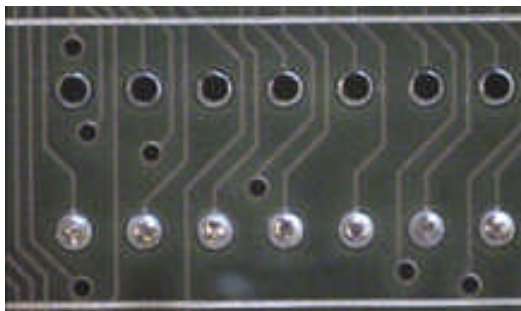
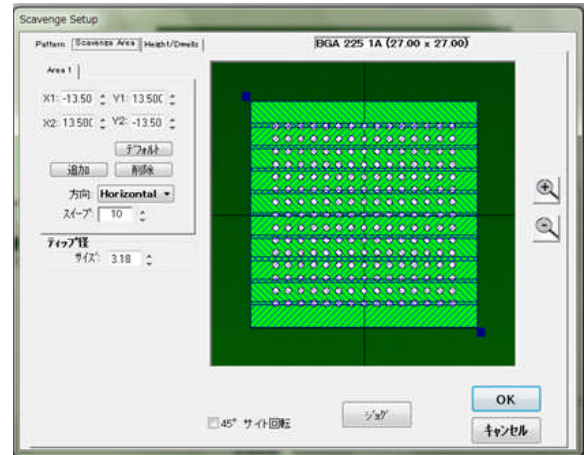
SUMMITリワークシステム専用、対象サイトから非接触で残留はんだを自動除去できる機能です。DHS(ダイナミックハイトセンシング)機能は、はんだ除去ノズル先端と基板表面のギャップをリアルタイムで検出し、一定のギャップを維持しながら、非接触で残留はんだを除去する優れた機能です。はんだ除去ヘッドは最大80mmの範囲内で、パッケージのパターン、加熱温度、移動速度、Z軸高さ等のプログラムを設定でき、簡単に高度なはんだ除去を可能にします。

はんだ除去のセットアップはソフトウェア上で簡単に設定できます。

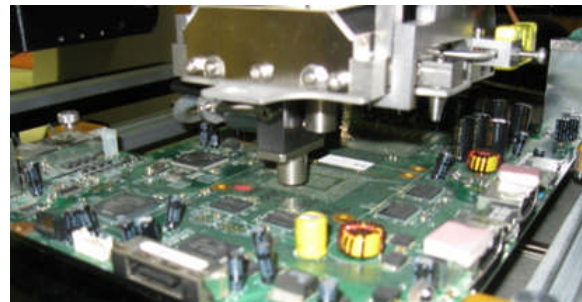
はんだ除去パターンは、フルBGAパターン、ペリメーターBGAパターン、千鳥パターン、リードパターンの4種類から選択できます。

はんだ除去ノズルの径を入力すると、除去ノズルの最適な軌道を自動で表示、軌道の確認および編集が簡単に行えます。

- プロセス温度コンピューター制御
- 基板プレヒート温度制御
- ダイナミックハイトコントロール
- 均一な残留はんだ除去
- 非接触且つ一定速度でのはんだ除去による基板過熱防止



スルーホールのはんだ除去(上段)も可能



BGA取り外し後の残留はんだ除去



モバイル端末サイズの実装基板リワークに適した多機能リワークステーション SRT Micra



はんだ除去専用システム400S/STもご用意しております。

詳細は、株式会社 シンアペックス 電子機器プロジェクト部門までお問合せ下さい。